

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-070

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的

停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688012	中微公司	A 股 停牌	2025/12/19			

一、停牌事由和工作安排

中微半导体设备(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“杭州众硅”“标的公司”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易不构成重大资产重组。此外，预计本次交易亦不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中微公司，证券代码：688012）自 2025 年 12 月 19 日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称	杭州众硅电子科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91330185MA2CC0D69L
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 88 号 1 幢一层
法定代表人	GU HAIYANG
注册资本	11,562.0108 万元
成立日期	2018-05-23
经营期限	2018-05-23 至 9999-09-09
经营范围	一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杭州众硅主营业务为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案；主要产品为 12 英寸的 CMP 设备。

（二）交易对方的基本情况

本次交易的主要交易对方为杭州众芯硅工贸有限公司、上海宁容海川电子科技合伙企业（有限合伙）、杭州临安众芯硅企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州临安众硅管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州芯匠企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州众诚芯企业管理合伙企业（有限合伙）、朱琳。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买标的公司控股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司已与标的公司主要股东杭州众芯硅工贸有限公司、上海宁容海川电子科技有限公司合伙企业（有限合伙）、杭州临安众芯硅企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州临安众硅管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州芯匠企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州众诚芯企业管理合伙企业（有限合伙）、朱琳签署了《发行股份购买资产意向协议》，约定公司拟通过发行股份的方式购买标的公司控股权，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。

四、交易目的

本次交易，是中微公司构建全球一流半导体设备平台、强化核心技术组合完整性的战略举措之一，旨在为客户提供更具竞争力的成套工艺解决方案。中微公司的主要产品是等离子体刻蚀和薄膜沉积设备，属于真空下的干法设备。杭州众硅所开发的是湿法设备里面重要的化学机械抛光设备（CMP）。刻蚀、薄膜和湿法设备，是除光刻机以外最为核心的半导体工艺加工设备。通过本次的并购，双方将形成显著的战略协同，同时标志着中微公司向“集团化”和“平台化”迈出关键的一步，符合公司通过内生发展与外延并购相结合、持续拓展集成电路覆盖领域的战略规划。

五、风险提示

截至目前，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日